

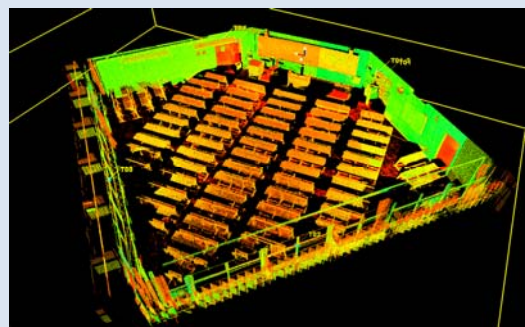
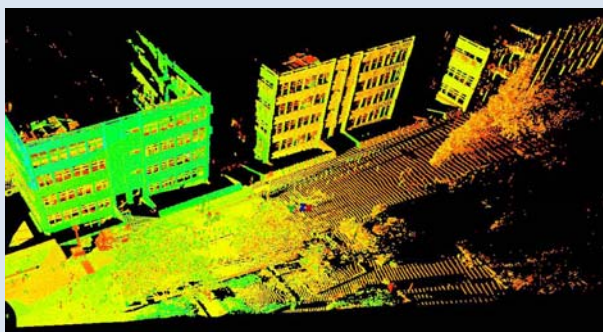
[開催案内]

早稲田大学理工学研究所 70周年記念特別シンポジウム

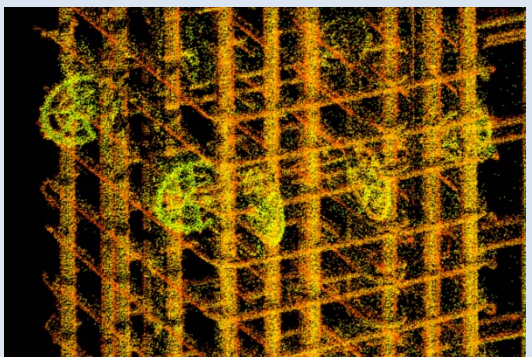
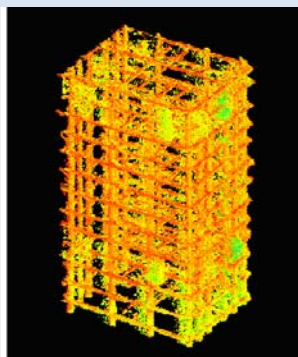
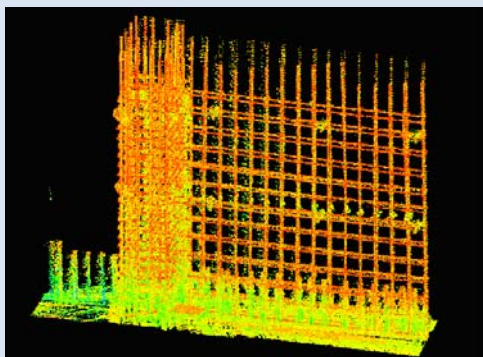
建築生産における 3次元スキャナーと3次元計測に関する課題と将来 (開催日：2010年11月19日(金) 13:00-18:00)

3次元スキャナーの用途例

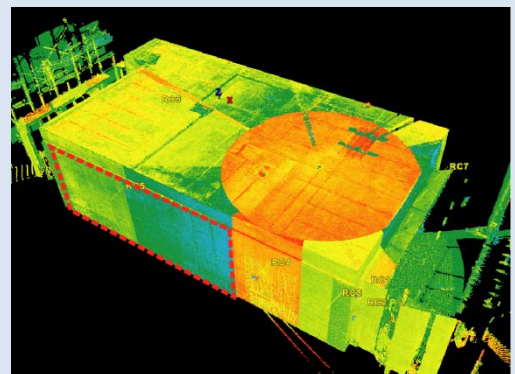
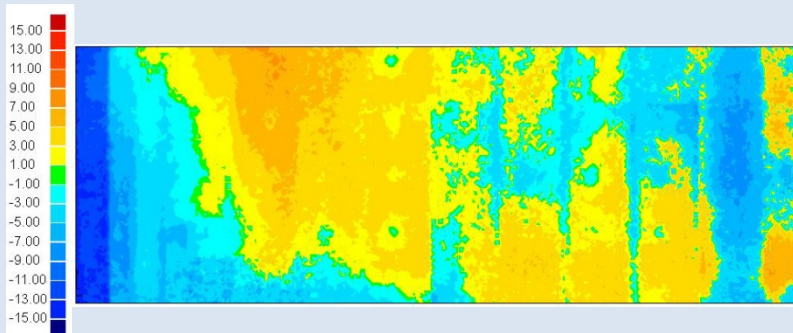
既存建築物の形状・寸法の現状把握
工事における品質管理
建築物の竣工検査



大学施設における既存建物の形状・寸法の現状把握



鉄筋工事における品質管理のための配筋状況の把握



コンクリート躯体の施工精度の検査

プログラム

建築生産における3次元スキャナーと3次元計測に関する課題と将来

主旨：

建築生産においてはこれまで数多くの情報化技術が開発されて来ましたが、2000年代からは3次元情報を活用した統合的な情報化を意図したBIM(Building Information Modeling)へと発展しつつあります。本シンポジウムは、3次元情報の活用及び3次元スキャナーに関する特別講演とともに、建築生産への3次元スキャナーの活用を目指して行われつつある研究や実務への試行・応用事例についての招待講演を企画しました。本シンポジウムでは、3次元スキャナーの技術的課題や可能性、更にはその将来像を討議し、建築生産の新しい技術と仕組みを参加者とともに考えることを目的としております。

本シンポジウムを機会として、建築生産における3次元スキャナーの活用が活発化し、建築におけるICTの更なる高度化とともに、BIMの進展が図られることを期待しています。

なお、本シンポジウムは、早稲田大学理工学研究所70周年企画によるシンポジウム助成を受けて開催するものです。(参加、配布資料は無料)

●主催：早稲田大学理工学研究所

●開催日程：2010年11月19日(金) 13:00-18:00 (終了後、懇親会)

●場所：早稲田大学理工学術院校舎 55号館N棟1階大会議室

(住所：新宿区大久保3-4-1)

交通：地下鉄副都心線「西早稲田駅」より徒歩2分、JR「高田馬場駅」より徒歩13分

●プログラム (注：時間は概ねのスケジュールです。)

1. 趣旨説明 13:00-13:10 嘉納成男

2. 特別講演 13:10-14:30

建築生産における3次元情報の活用について

高橋 暁 (国土技術政策総合研究所)

海外・国内の3次元計測の技術動向について

河村幸二 (スパーポイントリサーチ)

3. 研究・事例発表(招待講演) 14:40-17:00

1 リニューアル工事における3次元スキャナーの活用

大浦章 (大浦工測)

2 PCa部材の品質管理における3次元スキャナーの適用検討

菅谷和人 (三井住友建設)

3 建築工事の出来形把握及び既存建築物の形状把握における3次元スキャナーの適用検討

蔡 成浩 (鹿島建設)

4 出来型精度確認における3次元スキャナーの活用

佐藤康弘 (大成建設)

5 3次元スキャナーを用いた施工品質確認手法の検討

竹内啓五 (清水建設)

6 建築物の形状把握と品質確認における3次元スキャナーの活用

嘉納成男 (早稲田大学)

4. パネルディスカッション (17:00-18:00)

(パネリスト：特別講演・招待講演講師)

●対象：発注者、設計者、総合工事業、測量業、研究者、CAD・ソフト開発者など、

●参加定員：100名程度

●参加・配布資料：無料 (事前に参加登録をお願いします。)

●問い合わせ先 (シンポジウム事務局)

早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科 嘉納研究室

電話：03-5286-3284

Fax:03-3207-4378

Email：kano@waseda.jp

担当：横山(秘書)、石田(大学院生)

参加登録（定員になり次第、締め切ります。）

Email: kano@waseda.jp、または FAX: 03-3207-4378 までお送りください。

Email の場合は、下記の必要事項を記載してお送りください。

(参加登録証をお送りします。なお、下記の Email アドレスをご連絡頂いた方には email でお送りします。)

「建築生産における 3 次元スキャナーと 3 次元計測に関する課題と将来」
標記シンポジウムに参加を申し込みます。

[参加者 1]

氏名 : _____

所属（組織名（企業名・大学名等）、所属部署名）：

職位 : _____

連絡先住所 : 〒 _____

電話 : _____

Email : _____

[参加者 2]

氏名 : _____

所属（組織名（企業名・大学名等）、所属部署名）：

職位 : _____

連絡先住所 : 〒 _____

電話 : _____

Email : _____